自锁开关三功能手电筒LED驱动IC

特性:

- ❖ 全亮、25%亮、暴闪三种功能循环模式
- ❖ 工作电压: 2.5V~5V
- ❖ 工作效率高达 92%
- ❖ 120mΩ低导通电阻(Lx电流1A)
- ❖ 高达 1.4A 的驱动电流能力
- ❖ 内置 NMOS 可直接驱动 1~5W LED
- ❖ SOT23-6 绿色封装
- ❖ 内置防电源反接功能

描述:

YXYX8133B是一颗三功能手电筒LED驱动芯片,采用了极小的SOT23-6无铅封装形式,仅需一颗电容器件,既节省PCB空间,又节省系统的成本,三节干电池或一节锂电池可以驱动1-5W的LED。YXYX8133B通过开关断开再接通来变换输出模式,可以实现亮度调节和暴闪功能。

YXYX8133B 可工作于-40℃~+85℃

应用范围:

- ❖ 移动手电筒
- ❖ LED 头灯
- ❖ LED 驱动

典型应用:

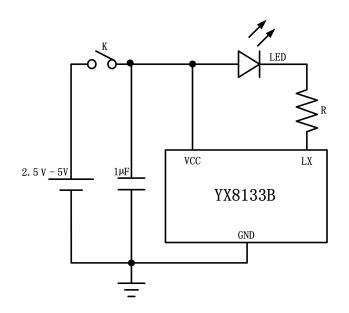
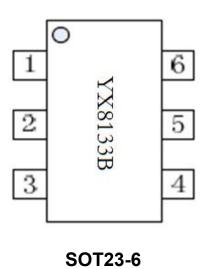


图 1. 典型应用电路

订购信息

器件型号	订购号	封装描述	存储温度	封装标记	包装选择
YXYX8133B	YXYX8133B	SOT23-6	-65℃ to +125℃		Tape and Reel

引脚信息



引脚号	名称	引脚功能描述
1	NC	空脚
2	GND	电源负极
3	NC	空脚
4	VCC	电源正极
5	NC	空脚
6	LX	LED输出,低有效

绝对最大额定范围

描述	范围	单位	
电源电压 (VCC)	-0.3 ~ 5.5	V	
其它引脚	-0.3 ~ VCC+0.3	V	
LED电流	1.5	Α	
存储结温	-65 to +125	°C	
焊接温度	260(10s)	°C	
势大设由(FCD)	HBM (Human Body Mode)	2000	V
静态放电(ESD)	MM (Machine Mode)	200	V

注1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

热损耗信息

描述	范围	单位	
封装热阻(θ _{JA}) "热阻(Junction to Ambient)θ _{JA} "	SOT23-6	200	°C/W
功耗, P _D @T _A =25°C "热阻(Junction to Case)θ _{JC} "	SOT23-6	0.5	W

推荐工作条件

描述	范围	单位
工作结温	-40 ~ 125	°C
工作环境温度	-40 ~ 85	°C
电源电压	+2.5 ~ +5	V
连续输出电流 (SOT23-6)	0.1~1.2	Α

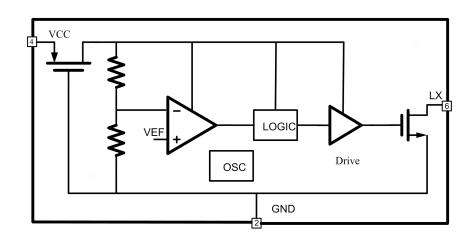
注 2: 推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。

电特性

(V_{CC}=3.8V, T_A = 25°C, T6LED, 除非特别说明)

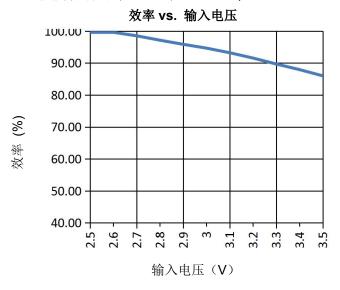
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电源电压	V _{CC}		2.5	3.8	5	V
空载电流	I _{DD}	V _{CC} =3.8V		262		μА
输出电流	I _{LX}				1.4	А
功率FET导通电阻	R _{DS(ON)}	V _{CC} =4V,100%模式,I _{LED} =1A		120		mΩ
25%亮工作频率	F _{25%}			250		Hz
暴闪频率	F _{FLASH}			8		Hz

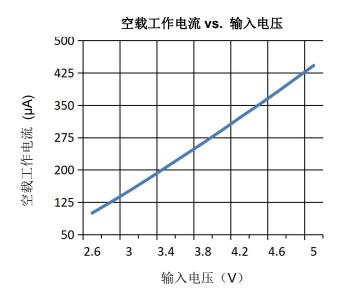
内部功能框图

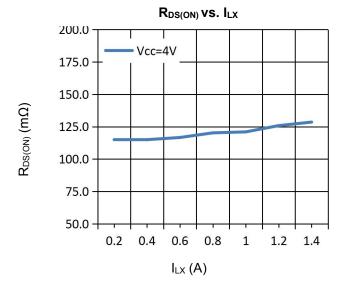


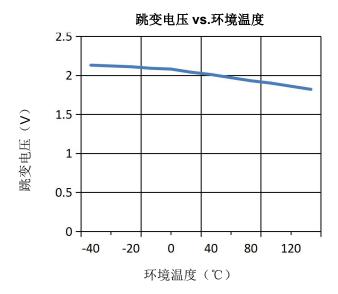
典型特性曲线

(除非特别说明, R=0Ω, TA=25℃)









功能描述

YXYX8133B是一款采用电源开关控制,可实现全 亮、25%亮、暴闪三种功能循环切换的LED驱动芯 片。

LED 驱动电流设置

LED 驱动电流可通过调节电阻 R 来实现,如图 1 所示,可以按照所需要的电流调节电阻 R 的大小,可参考计算公式:

$$I_{LED} = \frac{V_{BAT} - V_F - V_{ON}}{R}$$

式中:

VBAT 为电池电压;

V_F为 LED 正向电压;

Von为 MOS 管导通压降。

例:用 3 节 5#电池, V_F =3V, V_{ON} =0.12V,R=1.2Ω,则 I_{LED} =1.15A。

注:由于电池和引线规格的不同,计算结果会有一定误差,公式仅供参考。

YXYX8133B 最大可驱动 1.4A 的电流,电流的设定与调节要在 YXYX8133B 的最大电流驱动能力范围内,并且电阻的功率选择要适合,否则电路将不能正常工作。 YXYX8133B 在三节干电池或一节锂电池供电情况可直接驱动 1~5W LED。

功耗考虑

芯片结温依赖于环境温度、PCB布局、负载和封装类型等 多种因素。功耗与芯片结温可根据以下公式计算:

$$P_D = R_{DS(ON)} \times I_{OUT}^2$$

根据PD结温可由以下公式求得:

$$T_J=P_D\times\theta_{JA}+T_A$$

式中:

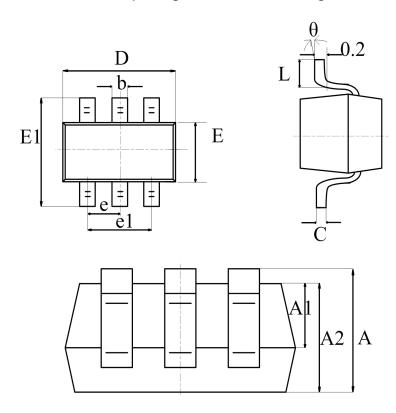
T」是芯片结温

T_A 是环境温度

θ」A是封装热阻

封装描述

SOT23-6 package mechanical drawing



SOT23-6 package mechanical data

	dimensions				
symbol	millin	neters	inches		
	min	max	min	max	
Α	1.050	1.250	0.041	0.049	
A1	0.000	0.100	0.000	0.004	
b	0.300	0.500	0.012	0.020	
С	0.100	0.200	0.004	0.008	
D	2.820	3.020	0.111	0.119	
E	1.500	1.700	0.059	0.067	
E1	2.650	2.950	0.104	0.116	
е	0.950 (BSC)		0.037 (BSC)		
e1	1.800	2.000	0.071	0.079	
L	0.300	0.600	0.012	0.024	
θ	0°	8°	0°	8°	